

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于投资半导体中高端引线框架生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：半导体中高端引线框架生产项目。
- 投资金额：项目总投资为 10,150 万元。
- 资金来源：自有资金以及自筹资金。
- 相关风险提示：
 - 1、本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效。投资项目是否能够实施尚存在不确定性，如因经营、资金筹措和人才流失等方面因素的影响，项目可能存在延期、变更或终止的风险。
 - 2、项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。
 - 3、拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

一、 对外投资概述

（一） 对外投资的基本情况

为了增强苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的市场竞争力和后续发展，并推动公司在半导体引线框架市场的开拓，全资孙公司池州昀钲半导体材料有限公司（以下简称“池州昀钲”）拟投资半导体中高端引线框架生产项目，项目总投资为 10,150 万元，项目分两期投资，第一期计划投资为 5,020 万元，第二

期计划投资为 5,130 万元。项目实施地点为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区。实施项目的资金来源主要为池州昀钇自有资金以及向银行申请授信额度。池州昀钇为本项目的实施主体，池州昀钇主营电子元器件的制造和销售，研发和制造半导体引线框架相关领域所需的精密电子零部件。

（二） 审批程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》，表决结果为：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。公司董事陆殷华对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为拟投资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、研发体系不可靠、相应的人才储备不足的风险。

董事会授权管理层相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事宜，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届监事会第十次会议审议通过《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》，表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、 实施主体概况

（一） 实施主体基本信息

企业名称	池州昀钇半导体材料有限公司
成立日期	2021 年 6 月 16 日
注册资本	100 万元

经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	甘子英
股权结构	公司 100%持股苏州昀钐精密冲压有限公司，苏州昀钐精密冲压有限公司 100%持股池州昀钐半导体材料有限公司

（二） 池州昀钐的主要财务状况

鉴于池州昀钐成立于 2021 年 6 月 16 日，截止目前，尚无可披露财务数据。

三、 项目概况

（一） 建设内容

1、本项目实施主体为池州昀钐半导体材料有限公司，拟在安徽省池州市建设半导体中高端引线框架生产基地，基地由车间、原料仓库、成品仓库组成的主要生产系统，以及办公、供配电系统、环保设施、节能设施及消防设施等组成。本项目采用进口冲压机台作为主要生产设备，并采购与之配套的国内先进的辅助生产设备，以金属原材料为主要原料。坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保产品的质量，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化半导体引线框架生产基地，以满足当前市场的需求，进而增强企业的市场竞争力和后续发展，并推动公司在半导体引线框架市场的开拓。项目达产年公司将实现 100 亿个引线框架基地的产能目标。项目总投资为 10,150 万元，建设期限为 24 个月，前 12 个月为第一期建设，计划投资 5,020 万元，后 12 个月为第二期建设，计划投资 5,130 万元。

2、项目的工程建设周期计划分以下阶段实施完成，包括：可行性研究、初步规划与设计、建设装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运行。

3、项目拟新建生产基地，规划建筑面积为 10,100 平方米，目前尚未取得相关土地。

4、购置冲压机、冲压周边设备、曝光机、镀银设备、压膜机、分片机、三次元等国内外先进设备。

四、必要性和可行性分析

（一）必要性

公司在多年的生产经营中，专注于精密电子零部件产品的开发和产品制造，严格把握生产质量，凭借优异的产品设计与优良的产品质量，与下游客户达成长期稳定的合作，但公司目前产品主要应用在消费电子领域，应用领域相对单一，对市场抗风险能力存在隐患。本次项目的投资将进一步加强公司在半导体领域的拓展，丰富产品结构，进一步发挥公司在精密电子零部件制造领域的竞争优势，扩大业务范围。

（二）可行性

1、本次投资项目是公司依据现有技术的基础上去扩大半导体领域的市场份额，同时公司培养了一批优秀的管理和技术团队，为整个投资项目的顺利实施提供了有力的人力保证。通过本次项目的实施，进行自主创新，大力增强公司在半导体集成电路引线框架产品方面的加工、设计、制作能力，进而提升公司的自主创新和开发能力，提高公司的整体竞争水平。

2、公司具备健全的治理结构，能够高质量与高效率的达成公司的工作指标。公司经过多年的发展已具备一定的项目计划、组织、协调、执行及控制能力，在项目管理团队的建设、项目计划的执行、项目成本的控制、项目质量的管理以及项目进度把控等方面都具备丰富的经验，为项目的顺利实施奠定了良好的基础。

3、经过多年的发展和实践，公司已建立了较为成熟的生产运营管理体系，基本实现了自动化生产。公司自动化事业部已自主研发出多种自动化生产、检测设备，不仅改善了公司产品品质，提高产品生产效率，同时也为公司进军半导体引线框架

领域提供了可靠保障。

4、在质量管理体系方面，公司制定的《质量手册》，明确了所有产品的生产流程及质量标准，确保公司为客户提供零缺陷的产品和服务。未来随着本项目的投产，公司对生产工艺环节升级的需求会不断增多，产品质量管理难度也会不断增大，公司将继续执行全面的品质管控，汲取以往的设备研制、质量管理经验，为本项目的顺利实施提供经验支持。同时，随着公司在半导体引线框架领域产品产能的增加，公司将继续招募行业内营销人才，完善市场营销团队，为产品产能消化提供基础保障。

五、 对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于完善公司的产业布局，有利于公司开拓新市场，增强公司在多领域发展的综合竞争力，同时会给公司带来新的利润增长点，降低公司对单一或少数行业的依赖，加强抗风险能力，符合公司长远发展规划和发展战略。

六、 本次对外投资的风险

（一） 审批风险

本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效，投资项目是否能够实施尚存在不确定性。

（二） 资金筹措风险

项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。

（三） 财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出。拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

（四） 经营风险

本项目实施后，公司的生产管理范围将进一步扩大，组织结构和管理体系将不断扩充，公司在经营决策、资源整合、研发管理、人员管理等方面将面临更多的挑战，风险控制的难度大为增加。若公司现有的内部控制体系、技术人才的引进及培

养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模迅速扩张，各部门的工作无法对现有的规模做出相应的协调调整，将会产生管理上的风险，阻碍公司的经营和未来可持续发展。

（五） 人才流失风险

随着公司投资项目的发展，对具有丰富经验的专业人才需求增大，人才竞争日益激烈。如果公司不能持续吸引新的优秀人才加盟，或出现核心的技术、管理人员大规模流失，将给公司经营活动带来较大影响，公司的竞争优势将无法保持，经营业绩将会下降。

（六） 项目建设用地取得风险

本次投资的建设用地还需通过当地政府部门审批，并通过政府招拍挂的形式取得，国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续存在不确定性风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月11日